一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以217102452为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国科微	股票代码	300672
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄然	叶展	
办公地址	长沙经济技术开发区东四路南段128号国科集成电路产业园9号楼	长沙经济技术开发区东四路南段128号国科集成电路产业园9号楼	
传真	0731-88596393	0731-88596393	
电话	0731-88218890	0731-88218891	
电子信箱	ir@goke.com	ir@goke.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司是工业和信息化部认定的集成电路设计企业，成立以来一直坚持自主研发的开发理念，公司长期致力于超高清智能显示、智慧视觉、人工智能、车载电子、物联网、固态存储等领域大规模芯片及解决方案的开发。自设立以来，公司一直专注于芯片设计及解决方案的开发、销售以及服务，主营业务未发生变化。公司拥有较强的自主创新能力，经过多年研发在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC芯片、MCU芯片、电源管理芯片、直播卫星信道解调、北斗导航定位、数模混合、高级安全加密、固态存储控制器芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等关键技术领域积累了大量的自主知识产权的专利、版图、软件著作权等核心技术。

公司的主营产品包括直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、8K解码芯片、泛屏商显芯片、智慧视觉芯片、端侧人工智能芯片、无线局域网芯片、SoC芯片、MCU芯片、电源管理芯片、卫星导航定位芯片、固态存储控制器芯片及相关产品等一系列拥有核心自主知识产权的芯片。公司产品主要应用于卫星智能机顶盒、有线智能机顶盒、IPTV、OTT机顶盒、TV/商显、网络摄像机、后端NVR/DVR视觉处理产品、固态硬盘产品相关拓展领域以及车载定位与导航、无人机等对导航/定位有需求的领域。基于公司在无线连接领域的技术积累，公司物联网业务已拓展至无线局域网网卡芯片领域；同时，公司正积极拓展AI PC、机器人等端侧人工智能等领域的应用。

（二）报告期内公司主要集成电路产品所属细分领域的主流技术水平及市场需求变化情况及对公司的影响，所在行业的竞争情况和公司综合优劣势及下一报告期内下游应用领域的宏观需求

1、超高清智能显示领域：

视频是信息呈现、传播和利用的重要载体，是电子信息产业的核心基础技术之一，目前视频技术正在从高清向超高清（4K/8K）普及，同时同X R及智能化场景演进。超高清视频以其更强的信息承载能力和应用价值，将为消费升级、行业创新、社会治理提供新场景、新要素、新工具，有力推动经济社会各领域的深刻变革，成为国民经济的新增长点和强劲推动引擎。

2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》（简称“行动计划”），明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。

2021年2月1日，中央广播电视总台8K超高清电视频道试验开播，全球首次实现8K超高清电视直播和5G网络下的8K电视播出。

2022年1月，工业和信息化部、中央宣传部、交通运输部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中央广播电视总台等六部门联合印发《“百城千屏”活动实施指南》，“百城千屏”活动以试点示范工程为引领，通过新建或引导改造国内大屏为4K/8K超高清大屏，丰富超高清视听媒体场景，加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展，催生新技术、新业态、新模式。2022年2月4日，北京冬奥会开幕，中央广播电视总台首次用8K技术实现了冬奥会赛事的直播，给全世界呈现了一场完美的体育盛会。2022年9月，在北京、上海、重庆、广东、福建、浙江、四川、山东、吉林、辽宁等22个省市市70多个城市的270余块户外地标大屏，同步直播了总台8K中秋晚会信号，为各地观众送上美轮美奂的超高清视觉体验。

在2023年杭州亚运会和成都世界大学生运动会中，8K直播将精彩的比赛更加细腻生动地展现在观众眼前。公司全系列芯片都支持HDR VIVID、Audio VIVID等国产标准，为国产技术的落地应用起到了积极的推动作用。

2026年春节歌欢晚会也采用对VIVID国产技术，为全球华人呈现了一场精彩盛典，国产音视频技术正在由试点专项大规模应用。

近年来随着“全国一网”“宽带中国”等政策快速推进，各地有线运营商和三大电信运营商都在大规模部署智能4K超高清机顶盒。有线电视全国一网整合基本完成，4K终端稳步发展，有线电视行业将会迎来全新发展机会，公司的4K芯片已经导入除西藏自治区以外的各省、市、自治区，并已经按规模稳定出货。2022年6月21日，国家广播电视总局公布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》，意见指出，自2022年7月1日起，直播卫星新增传输的电视频道应主要为高清超高清频道，新增机顶盒应为高清、超高清智能机顶盒，同时，有序推进直播卫星高清超高清机顶盒对标清机顶盒的替代；到2025年底，基本关停标清节目，这标志着从2025年开始，直播卫星将迎来一波换机潮，由标清过渡到高清和超高清。自2023年8月以来，广电总局推进电视双治理及机顶盒小型化工作，开展的电视“套娃”收费和操作复杂治理工作，旨在解决智能电视市场存在的收费项目繁多、操作流程复杂等问题，提升用户观看体验，同时推出小型化机顶盒和机顶盒电视一体化的规划。2025年广电总局联合工信部、中央广电总台出台《加快超高清高质量发展行动计划（2025—2027年）》强化端到端产业支撑，进一步推动超高清行业的发展。

基于上述政策及市场环境，公司针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片，于2022年在IPTV市场全面应用，在各运营商招标中取得了较好的市场份额，并开始在各省公司快速落地。2025年，四大运营商开展小型化机顶盒推广，将给公司带来新一轮的IPTV芯片需求，该领域整体出货平稳。另外，公司直播星4K智能机顶盒芯片及方案已在零售和个别省份的招标市场有一定出货，2025年持续耕耘零售市场并取得一定突破。

2024年，公司旗下共有5款产品通过鸿蒙4.0生态产品兼容性认证，全面拥抱国产生态，并于2025年上半年完成了鸿蒙5.0项目的开发和认证，2025年下半年开始鸿蒙产品已经在部分领域出货，覆盖教育、电力、金融及消费类等领域，生态建设逐步完善。

公司已通过自主研发积累了大规模SoC芯片设计技术、视频编解码技术、NPU技术、PQ技术、高级安全加密技术、低功耗设计技术、多晶圆封装技术以及嵌入式软件开发技术等关键技术。目前，公司超高清智能显示类产品涵盖卫星、有线、地面、IPTV/OTT及TV和泛屏商显等领域，产品线丰富，种类齐全。同时，公司正在基于现有音视频芯片，规划和开发AI芯片，AI芯片覆盖传统音视频行业的新一轮AI产业升级需求。

2、智慧视觉领域：

公司智慧视觉系列芯片产品主要应用于智能安防行业、消费类IPC、智能门锁、行车记录仪、无人机图传等视频采集类产品中。

人类在生产过程中，超过80%的信息是以视觉的形式获取，而以摄像头为主的视频采集类产品，作为人类眼睛的有效延伸，极大地增强了人类获取信息的效率。在人工智能与物联网融合的趋势下，智慧视觉SoC芯片在智能安防、智能家居等领域发挥关键作用，有着广阔的市场空间。据统计，全球视觉AI SoC市场规模自2020年的0.5亿颗增长至2024年的2.5亿颗，2020年至2024年复合年增长率为46.9%，预计全球视觉AI SoC出货量将在2029年进一步增长至9.5亿颗，2024年至2029年复合年增长率为31.3%。

在智能安防领域，国内受房地产市场降温影响，增长趋缓，但国外市场整体还保持较高的增速。以东南亚为主的海外新兴市场表现出强劲的增长势头，以欧洲为主的发达地区，对中高端摄像头产品也有着旺盛的需求。

消费类IPC产品保持着较强劲的增长势头。2025年全球消费类IPC出货量超1.92亿台，相比2024年的1.72亿台，同比增长约11.6%。其中国内总出货量约8050万台，占比41.9%。海外市场增长迅速，4G摄像头成为核心增长动力。在消费类IPC领域，技术和应用创新更为丰富，枪球联动、多目、双向可视对讲等形态产品层出不穷；老幼看护、宠物喂食、窗户摄像机等场景应用丰富。在无电无网无光场景中，4G、低功耗、AI ISP黑光等技术推动产品不断迭代创新，成为当下消费类IPC产品的一个热门方向。

为满足市场需求，公司在ISP图像处理、VENC视频编解码、NPU视频智能分析、低功耗等核心技术持续投入，丰富产品矩阵，不断提升产品竞争力。2025年第四季度推出高端4K AI智慧视觉SoC GK7606V1系列后，为进一步满足渠道及电商类市场中高端产品需求，于报告期内，公司推出普惠型4K AI ISP智慧视觉SOC GK7206V1系列，该系列集成我司最新的AI ISP图像处理技术，支持AOV低功耗技术，支持多路图像传感器同时输入处理，支持4K编码，CPU和NPU性能在该档次已有产品上进一步增强，对外还提供丰富的免费自研AI算法，助力客户快速场景落地。该产品一经推出，受到智能安防、消费类IPC等领域的客户广泛关注与好评，目前该产品已导入多家头部客户进行产品研发。在低端消费类IPC领域，还有着较大的长尾市场，针对该领域，在本报告期内，公司推出GK7203V1系列普惠型SoC芯片。该系列芯片内置通用型轻算力NPU，开放训练工具，满足客户个性化需求，同时也提供丰富的免费自研算法支持；低功耗方面，该系列也支持快启、AOV等技术，除此之外，提供也一并支持，提供RTC、POR、USB 2.0、SDIO、SPI、UART、I2C等丰富的外设接口，为客户提供低成本E-BOM解决方案。

在鸿蒙生态领域，公司积极参与鸿蒙生态建设，量产的智慧视觉系列产品均有配套鸿蒙解决方案，新推出产品也在快速适配中。

3、车载电子领域：

根据中国汽车工业协会数据，2025年，我国汽车产销量均突破3,400万辆，再创历史新高，连续17年稳居全球第一。其中，新能源汽车国内新车销量占比突破50%，成为我国汽车市场主导力量。新能源汽车产销量的增长带动了汽车智能化的迅速发展，促进了传感器和显示屏安装数量的增多，并且带动了图像处理、数据传输和智能处理需求持续增强。

（1）车载AI芯片市场目前主要分为两大类，一类为大算力芯片，主要应用场景为域系统控制器（座舱域，智驾域，舱驾一体等）；一类为小算力芯片，主要应用场景为相对单一的车载产品，如前向ADAS模组、智能行车记录仪、流媒体电子后视镜、电子外后视镜CMS、360全景泊车、驾驶员和座舱监测系统等。

在大算力芯片市场，当前主要供应商为美国英伟达和美国高通，上述两家企业在大算力芯片市场领域占据领先，另外，国内地平线等企业也陆续有量产项目。小算力芯片算力大多在8TOPS及以下，目前，小算力芯片市场主要供应商有TI、安霸、地平线等。

（2）MCU芯片，主要包括E.N.Z三大系列芯片，覆盖高中低端车载市场，满足智能座舱、智能车控、动力底盘等全车多领域适配，满足不同功能需求。目前主要芯片供应商有NXP、ST等。电源管理芯片主要为整车提供电力来源，包括LDO、DC/DC、PMIC，目前主要芯片供应商有MPS、TI等。

公司主研芯片产品包括小算力车载AI芯片和MCU芯片及电源管理，目前形成了系列化芯片产品布局，公司几大系列芯片组合，形成“算力+控制+能源”的完整车规芯片生态闭环。

4、人工智能领域：

2024年3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中提出深入推进数字经济创新发展，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。这标志着人工智能将成为未来经济的重要发展引擎。人工智能的发展离不开算力基础设施的支撑。

2025年政府工作任务中明确提出，激发数字经济创新活力，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。扩大5G规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加快完善数据基础制度，深化数据资源开发利用，促进和规范数据跨境流动。促进平台经济规范健康发展，更好发挥其在促创新、扩消费、稳就业等方面的积极作用。2025年两会更明确指出了人工智能的发展方向，其中明确提出“大模型+智能终端”的发展方向，同时随着以DeepSeek为代表的通用大模型技术及MoE、模型蒸馏等代表性大模型技术的发展和成熟，标志着AI大模型智能终端产业将迎来快速发展和应用。

2025年，公司围绕“ALL IN AI”战略，基于自研先进MLPU技术，持续聚焦人工智能边缘计算AI SoC研发，基于大模型+SoC赋能智能终端大模型应用。

公司AI SoC系列化产品包括8TOPS小算力AIoT终端芯片、16TOPS边缘计算芯片，以及预研的64TOPS~128TOPS大算力芯片，形成AI算力低中高的AI SoC产品布局，主要应用于AIoT智能终端、AIPC、工业计算、机器人（含具身智能）等场景应用。

同时，基于MLPU的创新架构设计，公司积极布局AI生态建设，2025年内合作伙伴生态已覆盖国内主要的端侧大模型公司，并形成意向合作，为最终AI SoC系列产品上市提前布局。公司围绕大模型及其大模型产品，深度优化适配，提供从模型压缩转化、推理部署，应用开发端到端全栈大模型工具链，方便开发者和客户能够简单高效地完成模型部署和应用开发，打造更具通用性、可用性和应用性的AI SoC系列产品。

5、物联网领域：

（1）定位导航

北斗卫星导航系统（Beidou Navigation Satellite System）是我国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统，作为国家重要的空间基础设施，北斗应用产业化相关内容已写入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。2024年9月，我国成功发射北斗三号收官卫星（第59、60颗MEO卫星），进一步巩固系统全球服务能力，并开展下一代北斗系统新技术试验。

在政策支持方面，2024年1月工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，明确将卫星导航技术纳入未来产业布局。中国卫星导航定位协会发布的《2025中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5758亿元人民币，同比增长7.39%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.46%，达到1699亿元人民币。

面向未来，北斗四号研发已全面启动，计划2029年组网发射，2035年全面建成后将实现探空、室内及水下导航，构建全球首个“泛在融合型导航体系”。技术层面，北斗正与5G、物联网、云计算、大数据、人工智能深度融合，支撑智能驾驶、低空经济等新场景，催生更多数字化应用新场景，打造更多智能化服务新产品、新模式。北斗时空服务将遍及人们生产生活方方面面，这对我国数字经济发展和服务效益提升将形成极大推动力。

公司再次芯片均通过了工业和信息化部电子第五研究所的单北斗产品认证。

（2）无线局域网

无线局域网是一种使用无线通信技术连接计算机网络的方式，目前已经广泛应用于日常生活中，是一种设备间传递数据的便捷通信方式。目前，无线局域网技术正在向着高速高带宽低延时的技术方向演进，最新的无线局域网技术的通信带宽高达320MHz，最高速率可以达到30Gbps，AP单设备的延时可以稳定在3ms以内。无线局域网技术的发展催生出新的应用，这将为消费升级、行业创新、社会治理提供新场景、新要素、新工具，可有力推动经济社会各领域的深刻变革，成为国民经济的新增长点和强劲推动引擎。

近年来，无线局域网在认证、安全和网络性能等方面取得了显著的进步，技术的进步带来应用的蓬勃发展和产业的繁荣，具体的驱动力主要有以下几点：①互联互通技术的快速发展从根本上改变Wi-Fi产业的生态系统，推动运营商、公共场所服务商、互联网企业间建立Wi-Fi漫游关系，形成Wi-Fi漫游联盟；②网络性能及容量显著提升，应用范围显著扩展，对于网络运营商来说，其对Wi-Fi网络的技术需要包括出色的传输速度、网络容量和网络密度，以满足数据流量迅猛上升的客观需求；③移动互联网和物联网技术的迅猛发展驱动数据流量的中心从有线到无线的加速转移。

除了技术方面的推动外，在业务层面，增强现实、新一代游戏的应用以及大屏终端、超高清显示器、四屏融合等新型终端体验的鹊起也推动了Wi-Fi应用的普及；在政策方面，“十三五”期间提出了构建先进适宜的无线宽带网，深入普及高速无线宽带，实现乡镇及周边公共区域无线广覆盖的行政村全面深度覆盖，在城镇热点公共区域推广免费高速无线局域网接入，政策的加持也促进了无线局域网的普及。在技术、业务和政策的多重推动下，Wi-Fi广泛应用于路由/网关、手机/平板、TV/OTT/IPTV、AR/VR、车载、笔电、IPC、图传、家电等领域。根据半导体行业调查机构TSR于2022年6月发布的《2022 wireless Connectivity Market Analysis》，2024年，Wi-Fi的市场容量预计突破50亿只，并保持每年5%的复合增长率，在数量增加的同时，Wi-Fi市场还呈现应用的多元化增长，这对于Wi-Fi领域的后人者来说是一个很有利的因素，后人者可以根据新的产品需求研发出更适合市场需求的产品。

目前从全球来看，无线局域网网卡芯片的供应商主要集中在美国、中国台湾和中国大陆，其中美国的高通、博通及中国大陆的海思是高端芯片的代表；中国台湾的MTK和瑞昱在高端芯片占有一定的份额，在中低端芯片领域占有主导地位；国内的爱科微、希微、高拓在中低端芯片领域占有一席之地。

公司确定了立足中低端、积极发展中高端，并在低中高端实现无线局域网芯片的全面国产替代的策略。公司针对TV、IPTV以及OTT、AR/VR、车载市场、PC开发了Wi-Fi6 2T2R无线网卡芯片，目前该芯片正在导入国内主流的电视和运营商的方案厂商及网卡厂商，有部分客户已经实现小批量试产。在前述Wi-Fi6 2T2R的基础上，公司的Wi-Fi6 1T1R+蓝牙的Combo芯片正在进行同片调试，目前芯片功能和性能正常，有望在2026年Q3开始客户导入；同时，公司针对IPC、行车记录仪、图传、网卡市场开发的Wi-Fi4 1T1R无线局域网芯片已经量产。公司通过自主研发积累了2.4G和5G11ac频段的宽带射频技术、射频低噪声技术、低功耗技术、高性能无线通信算法、嵌入式开发以及多操作系统驱动开发技术等多项核心技术。目前，公司在着力推进无线局域网技术的研发布局，未来将形成低中高端芯片产品家族，同时将推出Wi-Fi与蓝牙、星闪等短距离无线通信技术融合的芯片产品及方案。另外，公司正在积极探索卫星通信芯片等新业务领域。

6、固态存储领域：

随着5G、AI、物联网、智能驾驶汽车等新兴技术的蓬勃发展，将加速走入数据产生和存储需求的爆发性增长阶段。固态硬盘存储在全球范围内继续保持高速增长，尤其中国的固态硬盘存储行业增速更快。得益于国内信息化的快速发展与“东数西算”国家级工程的启动，在超大规模数据中心用户的推动下，相关技术将推动高性能存储的未来发展。从消费级存储到企业级存储，中国固态硬盘行业将保持较高的增长率。2023年8月，财政部官网发布通知，针对国产计算机和操作系统的采购时企业公开征求意见，采购需求标准包括了便携式计算机、一体式计算机、通用服务器、台式计算机等，这是政府层面首次高层次地公开发布采购需求标准，此举意味着国产化将走向深化。

随着《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国数据安全法》等一系列法律法规的出台，在高安全领域，数据安全已然成为必须受到重视的问题之一。“十四五”规划的落地文件，也明确了加强密码类产品在国产化领域的应用。随着“放管服”改革进一步深化，商用密码技术推陈出新，我国商用密码产业蓬勃发展。

（三）公司所处行业竞争格局情况

1、超高清智能显示领域

公司超高清智能显示芯片主要应用在直播卫星机顶盒、有线机顶盒、IPTV/OTT机顶盒及TV/商显领域。在这些领域，主要的芯片方案供应商有国科微、晶晨股份、MTK、瑞芯微、全志科技等厂商。在有线机顶盒领域，公司目前产品持续出货并仍占据市场主导地位。在IPTV/OTT领域，公司产品已完全进入国内三大运营商市场，并持续出货。同时，公司与运营商共同探讨了下一代智慧中屏芯片在智慧家庭场景中的AI应用需求及场景，待启动相关芯片的开发。在教育机、会议机及广告机等领域，由于鸿蒙生态的加持，公司处于上升势头。2025年全年出货有所上升，鸿蒙生态进一步完善，期望进一步增长。同时，依托鸿蒙生态，公司的4K超高清解码芯片在消费类市场取得一定突破，有望带来新一轮的增长。

2、智慧视觉领域

公司智慧视觉系列芯片主要应用在智能安防、消费类IPC等领域，在这些领域内，主要的芯片方案供应商有国科微、星宸科技、富瀚微、北京君正、联咏科技、瑞芯微、华为海思等厂商；公司在ISP图像处理、VENC视频编解码、NPU智能视频分析、低功耗等关键技术方面高强度投入，保持着行业领先的地位，为市场提供有竞争力的产品，可广泛应用于平安城市、智能交通、平安乡村、智慧楼宇、社区、智慧行车、智慧农场、智慧政务、智能家居等场景。

3、车载电子领域

公司推出的车载AI系列芯片主要应用在前装AEB系统、智能摄像头、行车记录仪、流媒体电子后视镜、电子外后视镜、摄像头监控系统、驾驶员疲劳监测系统、座舱监控系统、前视ADAS一体机等产品上。在上述产品领域中，主要芯片供应商有安霸、豪威、地平线等。

同时，公司推出的MCU系列芯片，低阶MCU面向车身控制，中阶切入智能座舱，高阶布局域控及底盘安全等核心领域，覆盖整个汽车电子各大系统。主要芯片供应商有NXP、ST等。公司推出的电源管理芯片，包括LDO、DC/DC、PMIC，给整个汽车电子提供供电来源，主要芯片供应商有MPS、TI等。

SoC芯片、MCU芯片与电源管理芯片共同形成“算力+控制+能源”的完整车规芯片生态闭环。

4、人工智能领域

公司人工智能AI SoC系列产品主要围绕大模型应用于机器人（含具身智能）、AI PC、无人机、工业计算等大模型智能终端领域。在这些领域，主要的芯片方案供应商有国科微、算能、芯动力、爱芯元智等厂商。在大模型+智能终端领域，公司MLPU架构是专门为大模型设计的创新AI架构，无论在大模型推理效率、功耗和成本上，都领先于传统NPU芯片，产品具有极强竞争力。同时基于MLPU创新架构已形成系列化低中高大模型AI SoC布局，产品研发节奏和规划市场领先。

5、物联网领域

（1）定位导航

近年来，北斗系统对我国经济社会发展的辐射带动作用日益显现，应用深度广度持续拓展。北斗系统已广泛进入各行各业，以及大众消费、共享经济和民生领域，深刻改变着人们的生产生活方式，产生了显著的经济和社会效益。目前，我国卫星导航与位置服务领域相关的企事业单位总数量已接近2万家，从业人员总数近百万。

随着北斗三号系统的建成并提供全球服务，国内外一大批专业企业进入该领域。资源向头部企业聚集效应明显，北斗导航芯片在设计和制造等关键环节已基本实现自主可控，国产北斗导航芯片模块出货量已达亿级规模。随着GNSS产品市场需求的快速增长，导航芯片小型化、低功耗趋势已日趋明显，芯片工艺从40nm到22nm再到12nm，体积更小，功耗更低，并且在逐步集成其他芯片功能和应用。目前芯片的重点技术攻关方向是低功耗、高灵敏度、高集成度、高精度、多源融合方向发展，并实现核心技术自主可控。公司的北斗芯片拥有完全自主知识产权，且工艺也处于国内领先水平。

（2）无线局域网

公司研发的无线局域网芯片，聚焦新一代通信技术应用需求，主要面向网络摄像机（IPC）、智能电视（TV）、IPTV/OTT机顶盒、行车记录仪、无线图传、个人电脑（PC）等多个重点应用领域，覆盖消费电子、智能监控、车载电子、网络通信等关键产业赛道，可满足各领域对无线连接的高性能、低功耗、高可靠性需求。

当前，上述应用领域的无线局域网芯片市场已形成较为成熟的竞争格局，主要供应商包括瑞昱、联发科（MTK）、爱科微、希微、高拓、南方硅谷等企业，各厂商凭借技术积累，市场渠道等优势占据相应市场份额。

分领域来看，在IPC、行车记录仪、无线图传领域，市场核心供应商为瑞昱、南方硅谷、高拓，其中瑞昱凭借技术领先性和市场渗透力，占据该细分领域50%以上的市场份额，竞争优势显著；在TV、IPTV/OTT机顶盒领域，市场主要供应商为瑞昱与联发科（MTK），两大厂商凭借完善的产品体系和稳定的供应链能力，主导该领域市场供给。

目前，公司已有多款无线局域网芯片产品实现量产，凭借稳定的性能、较高的性价比，已在相关细分领域形成初步市场布局；同时，新一代无线局域网芯片产品已进入研发攻坚阶段，各项研发工作有序推进。待在研产品完成全部开发及性能验证后，公司将严格遵循市场规律，统筹推进量产产品迭代升级与在研产品市场导入工作，重点对接各应用领域核心客户，逐步扩大市场份额，助力相关产业转型升级，为我国无线通信芯片产业自主可控发展提供有力支撑。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,604,694,260.58	7,667,633,581.22	-13.86%	7,340,270,887.08
归属于上市公司股东的净资产	3,791,050,294.81	4,081,571,282.09	-7.50%	4,120,312,791.49
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,791,097,793.15	1,977,891,796.40	-9.44%	4,231,262,884.84
归属于上市公司股东的净利润	-233,284,236.85	97,164,701.52	-340.12%	96,071,857.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-266,463,087.89	11,547,239.49	-2,407.50%	40,980,156.12
经营活动产生的现金流量净额	126,908,456.80	-47,696,070.65	366.07%	889,709,042.63
基本每股收益（元/股）	-1.0743	0.4488	-339.27%	0.4422
稀释每股收益（元/股）	-1.0743	0.4488	-339.27%	0.4422
加权平均净资产收益率	-6.91%	2.36%	-8.27%	2.36%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	305,263,053.60	436,118,042.02	430,643,438.96	619,073,166.57
归属于上市公司股东的净利润	51,506,903.17	-31,383,207.40	-12,717,290.78	-240,689,641.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,427,409.81	-35,772,813.91	-31,448,427.37	-243,669,256.42
经营活动产生的现金流量净额	31,604,475.51	88,634,202.81	-156,719,153.06	162,388,931.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,389	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,953	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南国科控股有限公司	境内非国有法人	17.98%	39,035,306.00	0.00	质押	9,365,000.00
长沙芯途投资管理有限公司	境内非国有法人	8.98%	19,491,864.00	0.00	不适用	0.00
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	4.50%	9,771,284.00	0.00	不适用	0.00
向平	境内自然人	3.81%	8,268,962.00	6,201,714.00	不适用	0.00
王春江	境内自然人	2.06%	4,472,600.00	0.00	不适用	0.00
深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠矿世红利27号私募证券投资基金	其他	1.48%	3,212,100.00	0.00	不适用	0.00
何宪彪	境内自然人	1.20%	2,615,500.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	2,364,742.00	0.00	不适用	0.00
深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠矿世红利27号私募证券投资基金	其他	1.07%	2,333,115.00	0.00	不适用	0.00
陈志贤	境内自然人	0.95%	2,061,282.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生100%持股公司，长沙芯途投资管理有限公司为公司实际控制人向平先生的一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

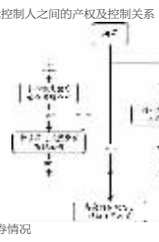
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

1、2025年5月22日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-044），公司正在筹划通过发行股份及支付现金等方式购买资产并募集配套资金，经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人的变更，不构成重组上市。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：国科微，股票代码：300672）自2025年5月22日开市时起开始停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。

2、2025年5月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-045），截至该公告披露日，公司与相关各方正在就本次交易方案进行协商、论证和确认。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。

3、2025年6月5日，公司分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波甬芯集成电路股权投资有限公司等11名交易对方合计持有的中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，兹暂不提议召开股东会、在相关审计、评估工作完成后，公司董事会将再次召开会议审议本次交易相关事项，依法定程序召集并提交股东会进行会面审议，具体安排以届时发出的股东会通知为准。

4、2025年6月6日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-048），根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：国科微，股票代码：300672）将于2025年6月6日开市起复牌。

5、2025年7月5日、2025年8月5日、2025年9月5日、2025年9月30日、2025年10月30日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-053、2025-054、2025-061、2025-064、2025-067）。

6、2025年11月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定，组织相关各方积极推进本次交易。由于本次交易相关事项无法在预计时间内达成一致，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及友好协商，认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，公司拟终止本次交易事项。

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2026-018

湖南国科微电子股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2160号文《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35,258,918股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币65.08元，募集资金总额2,294,650,383.44元，扣除承销费、保荐费等发行费用42,549,091.33元（不含增值税），实际募集资金净额为2,252,101,292.11元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月28日出具了XYZH/2022CSAA3B00044号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金项目累计投入1,693,620,344.70元，募集资金累计获得利息收入47,056,690.34元，尚未使用募集资金余额为605,537,637.75元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2025CSAA1B0113号《湖南国科微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度，公司募集资金使用总额为441,193,965.46元，尚未使用募集资金余额为220,487,862.10元（含利息收入和理财收入56,144,189.81元）。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2025年1月1日尚未使用募集资金余额	606,537,637.75
减：本期使用募集资金	441,193,965.46
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金	
直接投入募投项目的金额	441,193,965.46
加：扣除手续费的利息收入	56,144,189.81
2025年12月31日尚未使用募集资金余额	220,487,862.10

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况